

CHINVAY

APPROVAL SHEET

CUSTOMER :

ITME : 手机 SIM 卡座

MODEL : SC-1.2-6C-2.4

MATERIEL NO:

DATE : 08/08/2007

APPROVED BY:

深圳市创宇伟业科技有限公司

地 址: 深圳市龙岗区葵冲镇奔康工业区 B-7 栋 3 楼

电 话: 0755-8977 3388 8312 0030

传 真: 0755-8312 0032 8977 5511

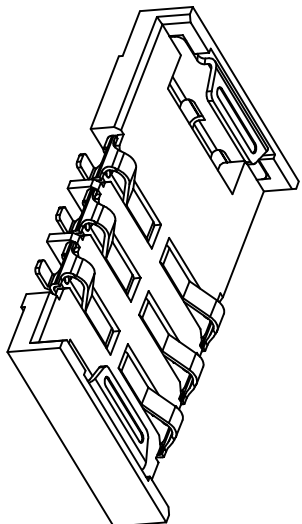
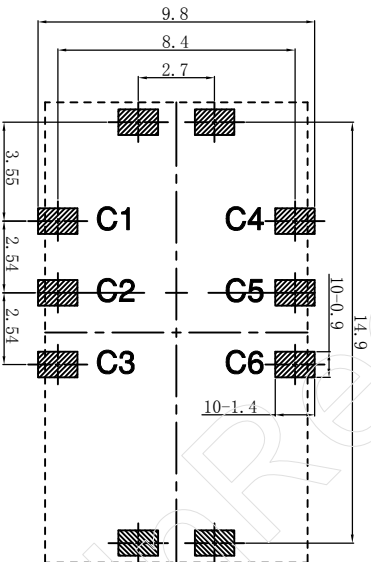
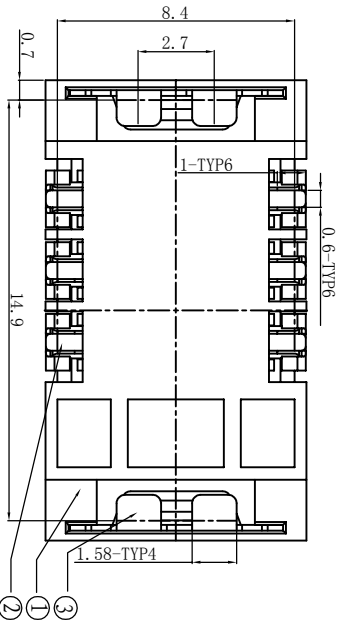
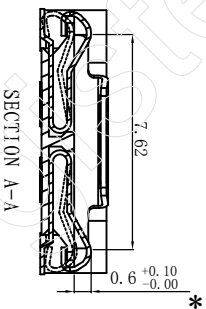
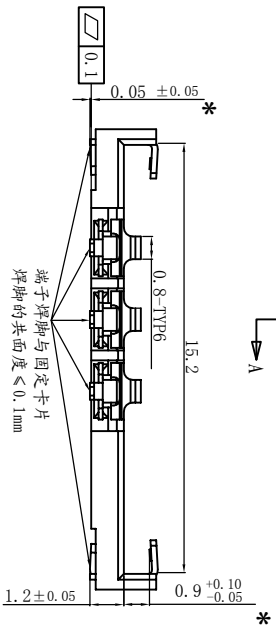
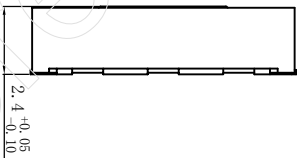
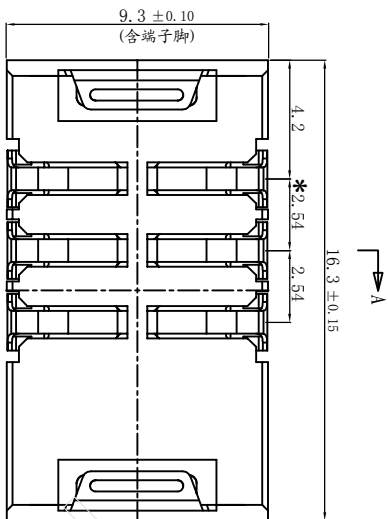
网 站: www.chinvay.com

阿里巴巴: cywy01.cn.alibaba.com

销售经理: 胡先生 手机: 136 0251 1930

邮 件 I: hkn@chinvay.com

邮 件 II: hukn999@163.com



1. 电气性能

- ▲ 接触电阻 初始 ≤ 30mΩ 实验后 ≤ 50mΩ
- ▲ 额定电压 30VAC/DC/MAX
- ▲ 额定电流 0.5A/MAX
- ▲ 耐压 500 V/min
- ▲ 绝缘电阻 ≥ 500MΩ/min (500V测试)

2. 机械特性

- ▲ 触点正向压力: 端子正向压缩0.3mm后, 压力在0.3-0.8N/pin之间
- ▲ 插拔寿命 插拔5000次后, 端子高度下降不超过0.1mm

- ▲ 机械寿命 正向压缩端子0.6mm, 500次后, 端子高度下降不超过0.1mm, 接触电阻 ≤ 50mΩ

- ▲ 工作温湿度 -20℃ ~ +60℃ / 5 ~ 85%R.H.

- ▲ 储存温湿度 -40℃ ~ +70℃ / 5 ~ 95%R.H.

- ▲ 耐焊接热 焊接温度260℃时, 要求10s不变形

- ▲ 平面度要求

- ▲ 端子焊脚与固定卡片焊脚的平面度 ≤ 0.1mm

- ▲ 产品符合ROHS标准.

序号	名称	数量	备注 (材料, 表面处理)	包装
3	固定卡片	2	不锈钢	载带
2	端子	3	磷铜, 镀金0.38um	
1	底座	1	PA46+30%GF, 黑色	


DIM	TOL	DIM	TOL
x		x	±2°
.x	±0.10	.x	±1°
.xx	±0.05	.xx	±1°
.xxx	±0.03	.xxx	±1°

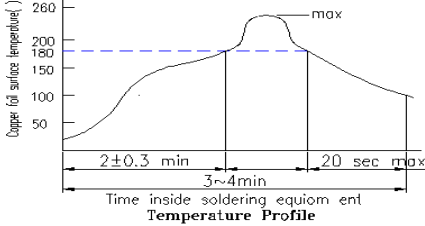
SC-1.2-6C-2.4

Sim card
Housing height
Height
Position

深圳市创宇伟业科技有限公司

REV.	VO.0	APPROVAL:	FILE NO.	DATE	TITLE: SIM CARD CONNECTOR
			DESIGN:		P/N: SC-1.2-6C-2.4
			CHECK:		SHEET: 1/1
					SCALE: 1:1
					UNIT: mm

系列类型	WINGBLOCK CONNECTOR	编写 WRN BY:	审核 CHECKED BY	批准 APPROVED BY
型号	SC-1.2-6C-2.4	LI MING	ZHANG BO	WANG WEI
VERSION 版本:	V0.0			
DATE 日期:	2007.10.18	2007.10.16	2007.10.16	2007.10.18
1. SCOPE 适用范围 本规格书适用: “WINGBLOCK CONNECTOR” 系列 This specification covers the requirements for: “WINGBLOCK CONNECTOR”				
2. Rating 额定值: DC 30V 0.5A				
3. CONSTRUCTION 构造				
3.1 Shape and dimensions are subject to drawing. 形状.尺寸根据图面确定.				
3.2 All part not allowed to exist rust 、 crack and poor planting.各部分无生锈、裂痕、电镀不良现象.				
4. Standard test conditions shall be 5 to 35℃ in temperature and 45 TO 85% in humidity. 温度 5~35℃ , 湿度 45~85% 标准状态下测试。				
Item 项目	Test condiction 测试条件		Performance 规格	
5. Electronical performance 电气性能				
5.1	Contact resistance 接触阻抗	Being measured at 1 KHz small current contact resistance meter. 在1kHz 小电流下测量。	30mΩ max. 30 毫欧 以下。	
5.2	Insulation resistance 绝缘阻抗	Measurements shall be made following application of DC 500 V potential across terminals and across terminals and frame for 1 minute. 在端子之间和端子与壳之间加 DC 500 V 条件下,持续 1 分钟测量。	500MΩ min. 500 兆欧 以上。	
5.3	Withstand voltage 耐压	AC 500 V(50Hz or 60 Hz)shall be applied across terminals and across teminals and frame for one minute. 在端子之间和端子与壳之间加 AC 500 V (50Hz 或 60Hz)条件下,持续 1 分钟测量。	There shall be no breakdown 无击穿现象出现.	
6. Mechanical performance 机械性能				
6.1	Operating force 接触压力		40gf MIN 40gf 以上	
6.2	Range 使用温度范围	在-20~+60℃温度内使用		
7. Durability 耐久性				
7.1	Lift test 寿命试验	5,000 cycles of operation at a rate of 15-18 cycles per minute with unloading 在无负载条件下,以每分钟 15-18 次的速度操作 5,000 次。	(1) Contact resistance 接触阻抗 200mΩ max.200 毫欧 以下 (2) 其它满足机械,电器性能.	
7.2	Heat test 耐热试验	85±2℃ for 96 hours, test after keeping in normal condition for 60 minutes. 在 85±2℃环境中放 96 小时, 再放在正常环境中, 60 分钟后进行测试。	Insulation resistance 50MΩ min.50 兆欧以上, 其它满足机械,电器性能.	

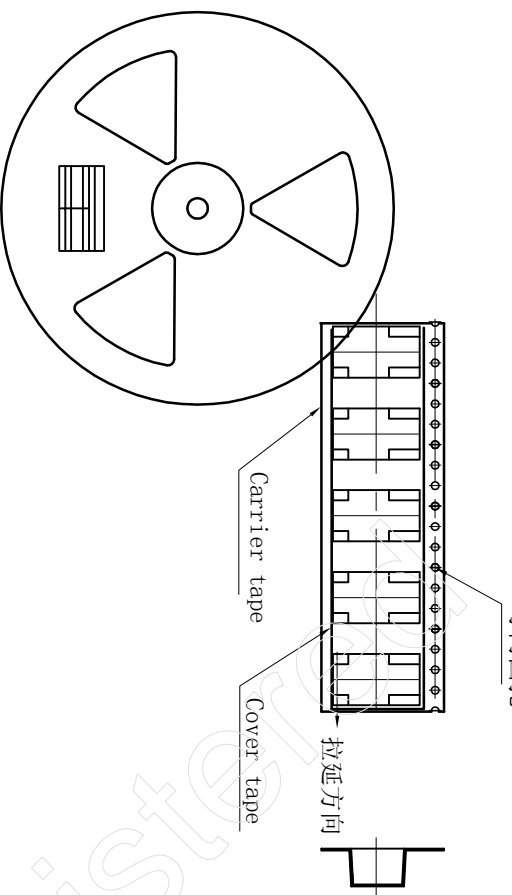
7.3	Humidity test 耐湿试验	40±2℃ 90-95%RH for 96 hours, test after keeping in normal condition for 60 min. 在 40±2℃ 90—95% RH 环境中放 96 小时, 再放在正常环境中, 60 分钟后进行测试。	Insulation resistance 50MΩ min.50 兆欧以上, 其它满足机械, 电器性能.
7.4	Cold test 耐冷试验	At -25±3℃ for 96 hours, test after keeping in normal condition for 60 min. 在 -25±3℃ 环境中放 96 小时, 再放在正常环境中, 60 分钟后进行测试。	There shall be no sign of damage mechanically and electrically 无任何迹象显示机械及电气性能损坏。
7.5	Resistance to soldering heat test 耐焊性试验	<p>soldering iron method: Bit temperature 350±10℃ application time 3±0.5 sec application time 3±0.5 sec. However excessive pressure shall not be applied to the terminal. 手焊接的时候温度需控制在 350±10℃, 时间为 3±0.5 秒, 不能在排脚上施加异常压力。</p> <p>Reflow Soldering Conditions: Preheat: Temperature on the copper foil surface should reach 180℃. 2±0.3 minutes after the P.W.B entered into the soldering equipment. Soldering heat: Temperature on the copper foil surface should reach the peak temperature of 240±5℃ within 20 seconds after the P.W.B enter into soldering heat zone.</p> <p>过回流焊条件: 预热: 电镀层表面的温度应达到 180℃, 2±0.3 分钟, 后电路板进入回流焊设备. 回流焊温度: 电镀层表面温度最高为 260±5℃ 且停留不超过 10 秒后电路板进入低温焊接处.</p>  <p style="text-align: center;">Temperature Profile</p>	Without deformation of case or excessive looseness of terminals electrical characteristics shall be satisfied. 本体无变形, 能满足于机械、电气性能。

PACKAGING SPECIFICATION

REV.	ECN NO.	LOCATION	DESCRIPTION	DATE	DESIGN
VO.0			初版发布		

内盒包装方式

1. 导向圆孔必须设在拉伸方向的右侧



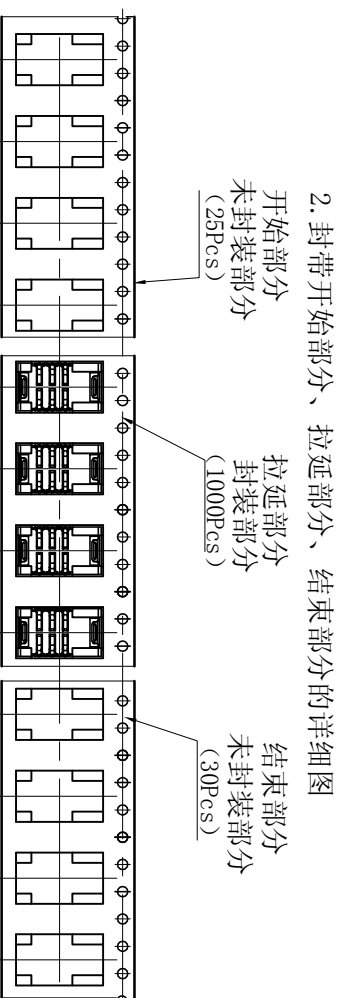
(1) 每个盘包装方式如图一所示。
 (2) 在开始缠绕料带时，取长60mm之纸胶带一段，20mm粘于料带上，40mm粘于REEL芯轴之缺口上，如图二所示。

(3) 料带卷绕完成时取长60mm之纸胶带粘住COVER TAPE并将其固定在REEL之圆周上。

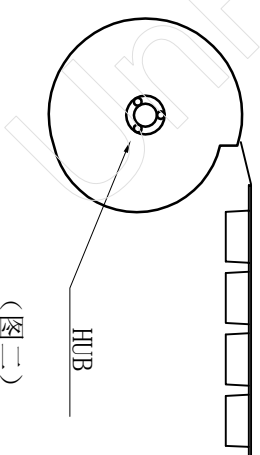
*. COVER TAPE有中断时可用宽18mm，长40mm之胶带将中断之两端各贴20mm，使其连接为一体。但连接后的两段COVER TAPE应在同一直线上。

外箱包装方式

- (1) 纸箱—Pcs.
- (2) 防水袋2Pcs.
- (3) 各叠好5个Reel (共10个) 分别放入防水袋中，然后封上防水袋，放入纸箱中。
- (4) 将外箱上层封口。



(图一)



(图二)

		FILE NO.	DATE	TITLE: SIM CARD CONNECTOR	
		DESIGN:			
DRAW NO.	CHECK:	P/N:	SC-1, 2-6C-2, 4	SHEET:	1/1
REV. VO.0	APPROVAL:	SCALE:	1:1	UNIT:	mm

深圳市创宇伟业科技有限公司